

2026 年 07 月 27 日

嘉立创（001232.SZ）

投资要点

◆ 7 月 21 日有一家主板上市公司“嘉立创”询价。

◆ 嘉立创（001232）：公司提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。公司 2023-2025 年分别实现营业收入 67.26 亿元/79.69 亿元/102.32 亿元，YOY 依次为 5.31%/18.48%/28.40%；实现归母净利润 7.34 亿元/10.54 亿元/13.06 亿元，YOY 依次为 28.10%/43.70%/23.93%。根据公司初步预测，2026H1 营业收入较 2025 年同期增长 33.22%至 54.71%，归母净利润较 2025 年同期增长 51.59%至 76.85%。

② 投资亮点：1、公司是国内产业互联网赋能电子制造流通的代表厂商之一，围绕样品、小批量需求构建出电子一站式产业互联网制造服务平台。公司自 2006 年成立起即从事 PCB 样板、小批量板制造业务，发展期间持续推进业务垂直整合与产业链延伸，目前依托自主搭建的下单网站及配套自有的生产仓储基地，成为典型的“互联网+制造”企业，业务覆盖 EDA/CAM 工业软件、PCB、电子元器件购销及电子装联等，并形成贯穿前端客户服务、中端技术支持和后端智慧工厂全业务链条的数字化运营模式；同时，由于 PCB 是电子元器件的载体，电子装联则是实现电子元器件在 PCB 上装配和电气连通的重要过程，三类需求相伴而生，公司凭借“PCB+电子元器件+电子装联”的垂直一体化布局，充分发挥电子产业链核心部件之间的高度协同效应，为客户在样品试制、小批量生产过程中提供“一站式、定制化、高效率、高品质”的综合产品与服务，进一步增强客户黏性和自身市场竞争力。现阶段，公司已积累庞大的客户群；截至 2025 年末，公司在线自助下单网站注册用户数超 950 万，其中 2025 年付费用户超 130 万、年交付订单量超 2100 万单。此外，Prismark 统计数据显示，高价值多层 PCB 下游需求持续景气，2025 年全球多层板市场规模 292.54 亿美元、约为单双面板市场规模的 3.5 倍；公司 PCB 产品最高层数可达 64 层，主要制程能力已达到同行业公司主流水平，募投高多层 PCB 产线项目有望进一步驱动公司业绩稳步增长。2、基于成熟的产业互联网运营经验，公司进一步布局 CNC 制造、3D 打印、FA 等“客户同源”的机械产业链相关业务，拟打造第二增长曲线。微电子与信息技术持续向机械行业渗透，并传统机械技术深度融合，带动自动控制、传感测试技术迭代升级；在此背景下，机电一体化技术应用边界不断拓宽，在智能制造、车载控制、消费电子、精密医疗等领域催生大量高价值创新场景。受行业趋势带动，公司服务的电子产业链客户需求已逐步从原有的电子产品延伸至机械部件；为顺应行业发展，公司基于成熟的“一站式产业互联网”运营经验，将同样的业务模式成功复制到 CNC 制造、3D 打印、FA 等“客户同源”的机械产业链相关业务。根据问询函回复披露，2024 年、2025 年公司机械产业链业务分别合计实现收入 2.29 亿元和 4.33 亿元，对应同比增长 122.07%和 89.29%，顺利实现同源客户引流转化。从客户体量观察，2025 年公司 3D 打印、CNC 和 FA 业务线年度付费客户数量分别为 21.83 万个、5.37 万个和 6.25 万个；对比 PCB 和电子元器件业务数十万规模的客户基数，当前机械板块来自原有电子客户的渗透率仍相对偏低，后续市场拓展空间充足。

电子 | 其他电子零部件III

交易数据

总市值（百万元）	
流通市值（百万元）	
总股本（百万股）	555.56
流通股本（百万股）	
12 个月价格区间	/

分析师

李蕙

SAC 执业证书编号：S0910519100001
lihui1@huajinsec.cn

分析师

戴铮等

SAC 执业证书编号：S0910526030001
daizhengzheng@huajinsec.cn

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（乔路铭）

-2026 年 78 期-总第 715 期 2026.7.14

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（龙鑫智能）-2026 年 76 期-总第 713 期 2026.7.13

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（泰诺麦博）-2026 年 77 期-总第 714 期 2026.7.10

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（欧伦电气）-2026 年 75 期-总第 712 期 2026.7.9

华金证券-新股-新股专题覆盖报告（永励精密）-2026 年 73 期-总第 710 期 2026.7.4



① **同行业上市公司对比：**根据主营业务的相似性，选取兴森科技、金百泽、迅捷兴、四会富仕、强达电路、云汉芯城为嘉立创的同行业可比上市公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 24.51 亿元，平均 PE-TTM（剔除异常值及负值/算术平均）为 69.35X，平均销售毛利率为 20.59%；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。

◆ **风险提示：**已经开启询价流程的公司依旧存在因特殊原因无法上市的可能、公司内容主要基于招股书和其他公开资料内容、同行业上市公司选取存在不够准确的风险、内容数据截选可能存在解读偏差等。具体上市公司风险在正文内容中展示。

公司近 3 年收入和利润情况

会计年度	2023A	2024A	2025A
主营收入(百万元)	6,726.1	7,968.9	10,231.7
同比增长(%)	5.31	18.48	28.40
营业利润(百万元)	901.7	1,221.3	1,533.0
同比增长(%)	26.70	35.44	25.53
归母净利润(百万元)	733.5	1,054.1	1,306.3
同比增长(%)	28.10	43.70	23.93
每股收益(元)	1.47	2.11	2.61

数据来源：聚源、华金证券研究所

内容目录

一、嘉立创.....	4
(一) 基本财务状况.....	4
(二) 行业情况.....	5
(三) 公司亮点.....	8
(四) 募投项目投入.....	9
(五) 同行业上市公司指标对比.....	10
(六) 风险提示.....	11

图表目录

图 1：公司收入规模及增速变化.....	4
图 2：公司归母净利润及增速变化.....	4
图 3：公司销售毛利率及净利润率变化.....	5
图 4：公司 ROE 变化.....	5
图 5：2022-2030E 全球 PCB 行业市场规模及预测情况.....	6
图 6：2022-2030E 中国 PCB 行业市场规模及预测情况.....	6
图 7：2022-2030 年全球通用电子元器件行业市场规模及预测情况.....	7
图 8：2022-2030 年中国通用电子元器件行业市场规模及预测情况.....	7
图 9：2022-2026 年全球 EMS 市场规模及预测情况（亿美元）.....	8
表 1：公司 IPO 募投项目概况.....	10
表 2：同行业上市公司指标对比.....	11

一、嘉立创

公司是业内具有行业变革意义的电子产业基础设施综合服务提供商，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。其中，印制电路板业务方面，公司可满足客户“样板→小批量→中大批量”的 PCB 制造需求；电子元器件业务方面，主要通过全品类现货模式满足客户样品、小批量电子元器件的采购需求；电子装联业务方面，通过对工程管理及生产环节等流程的高效组织，快速响应样品、小批量客户的 PCBA 订单需求；而其他主营业务，则包含 EDA/CAM 工业软件、激光钢网等电子产业配套服务和与电子产业链服务具有“客户同源”特点的 3D 打印、CNC 制造、FA 机械零部件商城等机械产业服务。

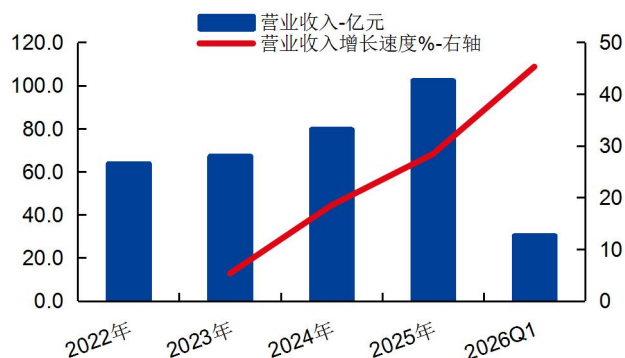
截至 2025 年末，公司已取得 26 项发明专利、161 项实用新型专利、293 项软件著作权，获得了“中国产业互联网百强企业”、“新财富半导体独角兽 Top50”、“中国产业数字化百强榜”、“集成电路独角兽企业 TOP50”、“中国工业数字化转型领航企业 50 强”、“杰出电子商务平台奖”、“胡润全球独角兽”、“年度数智化标杆企业”等多项行业内荣誉称号。

（一）基本财务状况

公司 2023-2025 年分别实现营业收入 67.26 亿元/79.69 亿元/102.32 亿元，YOY 依次为 5.31%/18.48%/28.40%；实现归母净利润 7.34 亿元/10.54 亿元/13.06 亿元，YOY 依次为 28.10%/43.70%/23.93%。根据最新财报情况，2026Q1 公司实现营业收入 30.29 亿元，同比增长 45.29%；实现归属于母公司净利润 3.76 亿元，同比增长 51.71%。

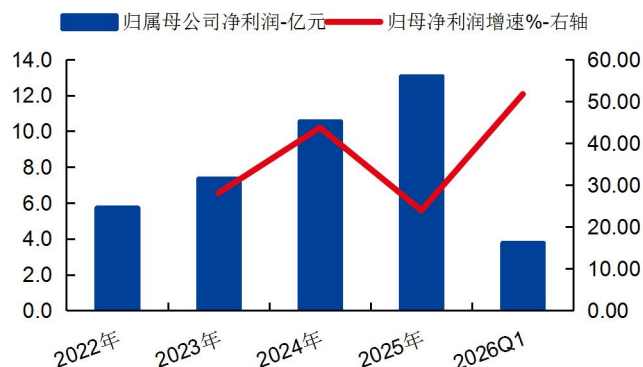
2025 年，公司主营业务收入按业务类别可分为四大板块，分别为 PCB（38.84 亿元，占 2025 年主营收入的 39.31%）、电子元器件（36.51 亿元，占 2025 年主营收入的 36.96%）、PCBA（17.89 亿元，占 2025 年主营收入的 18.11%）、其他类型业务（5.56 亿元，占 2025 年主营收入的 5.63%）。2023-2025 年，PCB 业务与电子元器件业务始终为公司主要收入来源，合计收入占比稳定在 70% 以上；与此同时，PCBA 业务的重要性持续提升，收入占比已由 2023 年的 11.80% 逐步增至 2025 年的 18.11%。

图 1：公司收入规模及增速变化



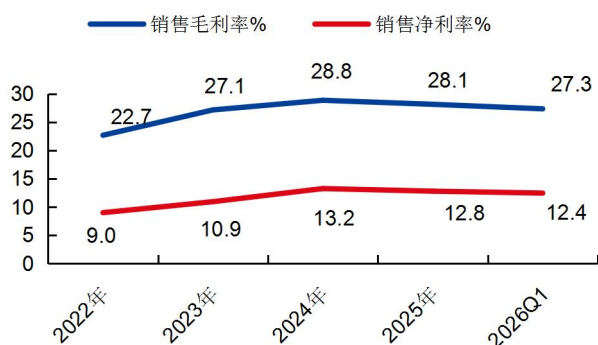
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 2：公司归母净利润及增速变化



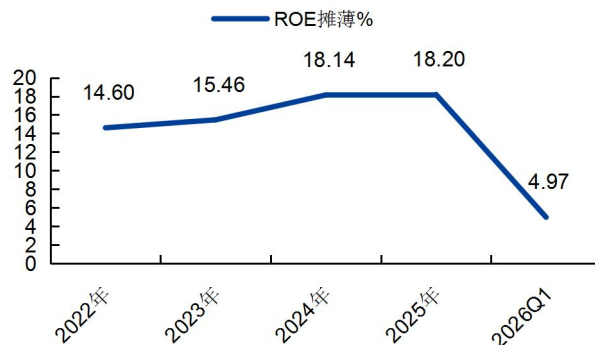
资料来源：iFind，华金证券研究所

图 3：公司销售毛利率及净利润率变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

图 4：公司 ROE 变化



资料来源：iFind，华金证券研究所

（二）行业情况

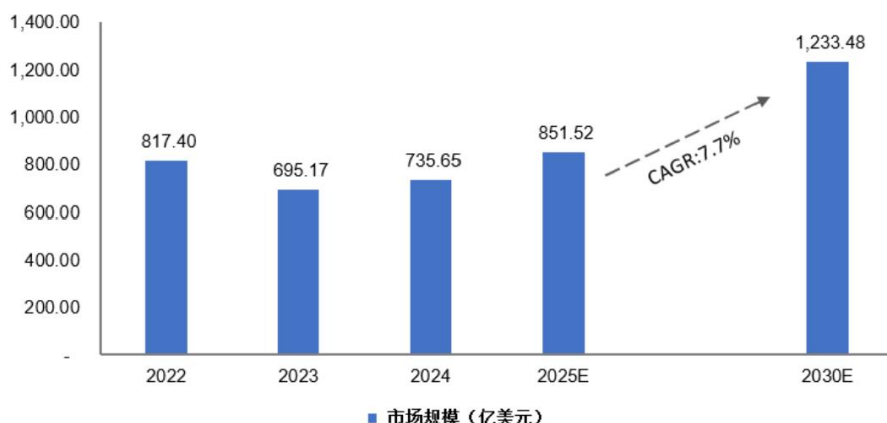
公司致力于提供 PCB 制造、电子元器件、电子装联等全产业链一体化服务。

1、印制电路板行业

印制电路板主要功能是使各种电子元器件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件；绝大多数电子设备都需要印制电路板为其提供装配电子元器件所需的机械支撑，实现其间的布线和电气连接或电绝缘、提供所要求的电气特性，其制造品质直接影响电子产品的稳定性和使用寿命，并且影响系统产品整体功能和市场竞争力，有“电子产品之母”之称。

在云技术、5G 技术、大数据、集成电路、人工智能、信息技术、工业 4.0 及物联网等产业加速发展的背景下，全球 PCB 行业产值稳步增长；根据 Prismark 统计及预测，2025 年全球 PCB 行业产值达 851.52 亿美元、同比增幅 15.75%，预计 2030 年全球 PCB 行业产值将达到 1,233.48 亿美元左右，期间年复合增长率约 7.7%。就细分产品来看，PCB 市场中大批量板、小批量板和样板的产值规模占比分别为 80%-85%、10%-15%和 5%，据此估算，2025 年全球小批量板的市场规模约为 85.15 亿美元至 127.73 亿美元，预计 2030 年市场规模将达到 123.35 亿美元至 185.02 亿美元；2025 年全球样板的市场规模约为 42.58 亿美元，预计 2030 年市场规模将达到 61.67 亿美元。

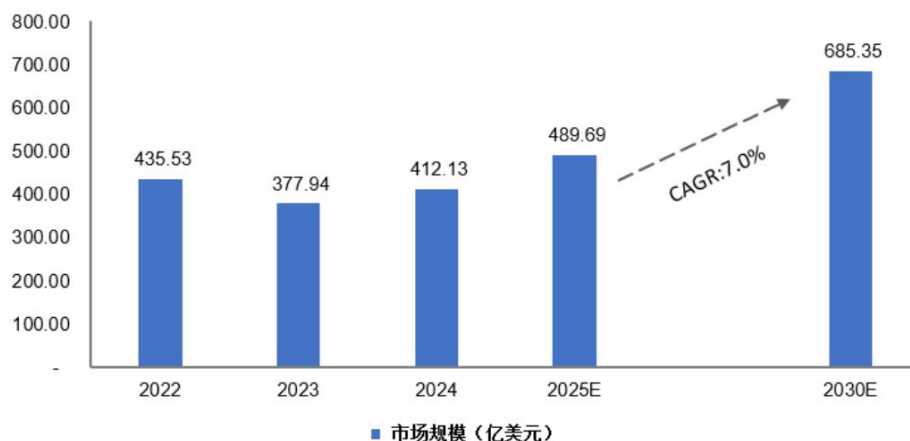
图 5：2022-2030E 全球 PCB 行业市场规模及预测情况



资料来源：Prismark，华金证券研究所

受益于中国电子信息产业的不断发展以及全球 PCB 产能转移，中国大陆 PCB 行业整体呈现出较快的发展趋势，2006 年中国大陆的 PCB 产值便超过了日本，成为全球第一大 PCB 制造基地。根据 Prismark 统计及预测，2025 年中国大陆 PCB 市场规模达 489.69 亿美元，同比增幅 18.82%；预计 2030 年将增至 685.35 亿美元，期间年复合增长率为 7.0%。按产品类别（大批量板、小批量板、样板）拆分来看，2025 年中国 PCB 小批量板的市场规模约 48.97 亿美元至 73.45 亿美元、预计于 2030 年将达到 68.54 亿美元至 102.80 亿美元，PCB 样板产业 2025 年市场规模约为 24.48 亿美元、预计在 2030 年将达到 34.27 亿美元。

图 6：2022-2030E 中国 PCB 行业市场规模及预测情况



资料来源：Prismark，华金证券研究所

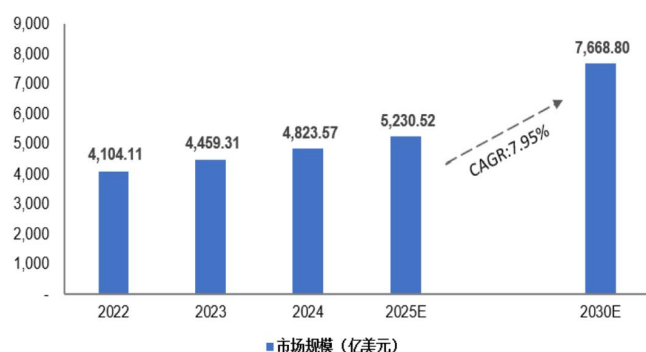
2、电子元器件行业

电子元器件行业是电子信息产业的基石，其广泛应用于航空航天、通信、能源、医疗、家电、交通等各个领域，影响着国民经济与社会生活的方方面面，是现代电子工业的基础。

根据 The Business Research Company 研究报告，2022 年至 2024 年全球通用电子元器件行业市场规模从 4,104.11 亿美元增长至 4,823.57 亿美元，年均复合增长率为 8.41%；预计 2030 年市场规模将达 7,668.80 亿美元，2025 年至 2030 年全球通用电子元器件行业年均复合增长率约 7.95%。国内市场来看，2022 年至 2024 年中国通用电子元器件行业市场规模从 530.31 亿美

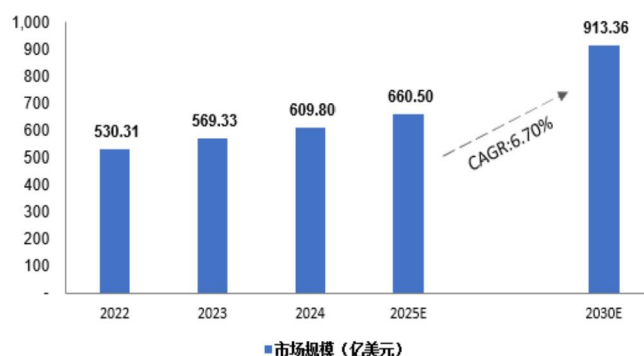
元增长至 609.80 亿美元，年均复合增长率为 7.23%；预计 2030 年市场规模将达 913.36 亿美元，2025 年至 2030 年中国通用电子元器件行业年均复合增长率约 6.70%。

图 7：2022-2030 年全球通用电子元器件行业市场规模及预测情况



资料来源：The Business Research Company，华金证券研究所

图 8：2022-2030 年中国通用电子元器件行业市场规模及预测情况



资料来源：The Business Research Company，华金证券研究所

电子元器件以分销流通为主。电子元器件产业链主要由上游的原厂、中游的电子器件分销商及下游电子产品制造商三个环节构成。在电子元器件领域里，不足整体电子产品制造商总数 1% 的超级客户主要直接向原厂采购，采购金额为总体市场份额的 44% 左右，而其余 99% 以上的制造商主要通过分销商渠道采购约 56% 的市场份额。在电子元器件上游原厂与下游需求方之间存在一个规模巨大的流通市场，分销商在其中发挥了重要作用。

3、电子装联行业

电子装联（PCBA）是指依据设计方案将各类电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在 PCB 上，实现装配和电气连通的制造过程，系 PCB 制造的下游环节；其归属于电子制造服务（EMS）行业，为 EMS 服务的主要组成部分之一。

EMS 行业系从集成电路表面贴装技术发展而来，随着电子产品的不断升级，其经过持续革新已逐渐成为全球电子产业垂直分工体系的重要一环。EMS 服务通常包含原材料采购、NPI、PCBA、成品组装、仓储物流等环节，通常围绕 PCB 产业展开。EMS 行业发展初期主要为品牌商提供 SMT 服务，随着产业链分工的进一步细化以及上下游合作模式的不断完善，品牌商逐渐将产品设计、工程开发、物料采购与管理、生产制造、物流运输、测试与售后服务等环节委托给 EMS 厂商，使得 EMS 行业的业务范围已全面覆盖整个产品生命周期的服务，行业市场规模逐渐增大。

随着 EMS 行业模式的日益成熟以及行业内企业服务能力的持续提升，全球 EMS 行业呈现出服务范围日益广泛、业务总量整体上升的发展趋势；根据 New Venture Research 报告显示，2016 至 2021 年全球 EMS 行业市场规模从 3,292 亿美元增长至 6,827 亿美元，年均复合增长率约为 15.71%，总体呈稳定增长态势，预计 2026 年全球 EMS 市场规模有望达到 9,465 亿美元，2021-2026 年复合增长率约 6.75%。

图 9：2022-2026 年全球 EMS 市场规模及预测情况（亿美元）



资料来源：New Venture Research，华金证券研究所

随着全球电子制造产能向中国转移，众多 EMS 厂商在我国投资建厂，全球 EMS 行业逐渐向中国大陆转移，国内 EMS 企业迎来蓬勃发展。此外，国内众多电子产品品牌商如华为、中兴、小米等在国际市场逐步崛起，其对产品质量、功能和性能的高标准要求及订单需求，进一步带动了国内 EMS 服务水平的迅速提升。在国内良好的政策、完善的产业链、充足的劳动力、雄厚的资本及庞大消费市场的支持和推动下，中国 EMS 行业迎来良好发展机遇，在长三角、珠三角和环渤海地区率先形成相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、网络通信、工控医疗以及计算机等行业的上下游配套需求实现产业集聚。

目前国内的 EMS 服务需求主要可分为两类：一类是中大批量订单需求，主要面向大型品牌商或者终端电子产品制造商等；另一类是样品、小批量订单需求，主要面向中小型企业、科研院所及工程师等。截至目前，国内中大批量 EMS 服务领域的竞争已相对饱和，既有富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等全球主要 EMS 公司进驻，也有比亚迪、环旭电子、深科技、光弘科技等本土 EMS 厂商强势崛起。而国内样品及小批量 EMS 服务领域的参与者相对较少，其主要服务于客户的产品技术研发及硬件创新阶段，下游应用领域涵盖消费电子、汽车电子、通信、工控医疗等，随着未来电子产品的不断创新与迭代升级，来自于产品技术研发及硬件创新的需求将持续增加，未来市场前景广阔。

相较于中大批量 EMS 服务，样品及小批量 EMS 服务的产品类型更为丰富、工艺迭代速度更快、个性化需求更多，具有明显的“小批量、多样化、快交付”特点，对生产企业的计划、实施、控制和管理的要求较高。截至目前，国内主营样品、小批量 EMS 服务的企业较为分散且规模普遍较小、技术能力和装备水平参差不齐，缺乏品牌知名度与市场占有率较高的优质企业。未来，具备柔性化制造服务能力，业务范围涵盖产品生命周期更长，能够贴近客户需求并快速响应的 EMS 服务企业将拥有更广阔的市场空间。

（三）公司亮点

1、公司是国内产业互联网赋能电子制造流通的代表厂商之一，围绕样品、小批量需求构建出电子一站式产业互联网制造服务平台。公司自 2006 年成立起即从事 PCB 样板、小批量板制造业务，发展期间持续推进业务垂直整合与产业链延伸，着力打造电子产业一体化服务能力。目前，公司依托自主搭建的下单网站及配套自有的生产仓储基地，成为典型的“互联网+制造”企业，业务覆盖 EDA/CAM 工业软件、PCB、电子元器件购销及电子装联等，并形成贯穿前端客户服务、中端技术支持和后端智慧工厂全业务链条的数字化运营模式；同时，由于 PCB 是电子元器件的载体，电子装联则是实现电子元器件在 PCB 上装配和电气连通的重要过程，三类需求相伴而生，公司凭借“PCB+电子元器件+电子装联”的垂直一体化布局，充分发挥电子产业链核心部件之间的高度协同效应，为客户在样品试制、小批量生产过程中提供“一站式、定制化、高效率、高品质”的综合产品与服务，进一步增强客户黏性和自身市场竞争力。现阶段，公司已积累庞大的客户群，涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构；截至 2025 年末，公司在线自助下单网站注册用户数超 950 万，其中 2025 年付费用户超 130 万、年交付订单量超 2100 万单。此外，Prismark 统计数据显示，高价值多层 PCB 下游需求持续景气，2025 年全球多层板市场规模 292.54 亿美元、约为单双面板市场规模的 3.5 倍；公司 PCB 产品最高层数可达 64 层，主要制程能力已达到同行业公司主流水平，募投高多层 PCB 产线项目有望进一步驱动公司业绩稳步增长。

2、基于成熟的产业互联网运营经验，公司进一步布局 CNC 制造、3D 打印、FA 等“客户同源”的机械产业链相关业务，拟打造第二增长曲线。微电子与信息技术持续向机械行业渗透，并与传统机械技术深度融合，带动自动控制、传感测试技术迭代升级；在此背景下，机电一体化技术应用边界不断拓宽，在智能制造、车载控制、消费电子、精密医疗等领域催生大量高价值创新场景。受行业趋势带动，公司服务的电子产业链客户需求已逐步从原有的电子产品延伸至机械部件；为顺应行业发展，公司基于成熟的“一站式产业互联智造”运营经验，将同样的业务模式成功复制到 CNC 制造、3D 打印、FA 等“客户同源”的机械产业链相关业务。根据问询函回复披露，2024 年、2025 年公司机械产业链业务分别合计实现收入 2.29 亿元和 4.33 亿元，对应同比增长 122.07%和 89.29%，顺利实现同源客户引流转化，该业务亦成为公司业绩新增长极。从客户体量观察，2025 年公司 3D 打印、CNC 和 FA 业务线年度付费客户数量分别为 21.83 万个、5.37 万个和 6.25 万个；对比 PCB 和电子元器件业务数十万规模的客户基数，当前机械板块来自原有电子客户的渗透率仍相对偏低，后续市场拓展空间充足，业务间的良好协同为机械产业链业务的发展奠定了坚实的基础。

（四）募投项目投入

公司本轮 IPO 募投资金拟投入 5 个项目。

1、高多层印制线路板产线建设项目：实施高多层印制线路板产线建设项目，从而进一步提升公司在高多层印制线路板领域样板、小批量板及中大批量板的生产制造能力，巩固公司的市场地位；据公司招股书预测，项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 23.23 亿元、年均新增净利润 4.08 亿元。

2、PCBA 智能产线建设项目：项目将扩大公司 PCBA 的配套生产规模，进一步提升市场份额，还将与 PCB 新增的产能密切配套，实现公司产业链各业务条线的协同发展。据公司招股书预测，项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 **14.52 亿元**、年均新增净利润 **2.43 亿元**。

3、研发中心及信息化升级项目：公司拟加强产业供应链整合能力、构建智能仓储中心，拟通过新建基地，配置自动化程度更高的 **AVG 机器人**、智能化货架和实验设备；此外，公司计划对现有仓储体系进行升级，以扩大现有的 **SKU 规模**，同时布局建设电子元器件实验室，用于满足不同产品的质量管控。据公司招股书预测，项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 **11.51 亿元**、年均新增净利润 **0.65 亿元**。

4、智能电子元器件中心及产品线扩充项目：公司拟通过新建基地，配置自动化程度更高的加工中心、数控车床及仓储设备等；项目建成后将提升公司的智能化、数字化水平，更好地实现公司的发展和管理需要，即通过建设 **FA 机械零部件商城**、**CNC 制造中心**、**3D 打印生产基地**，深化公司在产业链的战略布局。据公司招股书预测，项目投产后运营期每年可平均新增营业收入 **3.98 亿元**、年均新增净利润 **0.87 亿元**。

5、机械产业链产线建设项目：项目主要基于公司自主研发的 **EDA、1CAM 等行业软件**及智慧运营系统、数字中台系统等信息技术，通过采购行业领先的机器设备、软件系统，开展技术研究与应用开发，从而实现公司的软件处理及信息系统的优化升级。

表 1：公司 IPO 募投项目概况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金投资额 (万元)	项目投资期
1	高多层印制线路板产线建设项目	120,000.00	120,000.00	24 个月
2	PCBA 智能产线建设项目	115,000.00	115,000.00	24 个月
3	研发中心及信息化升级项目	48,000.00	48,000.00	24 个月
4	智能电子元器件中心及产品线扩充项目	74,000.00	74,000.00	24 个月
5	机械产业链产线建设项目	63,000.00	63,000.00	12 个月
	总计	420,000.00	420,000.00	-

资料来源：公司招股书，华金证券研究所

（五）同行业上市公司指标对比

2025 年度，公司实现营业收入 **102.32 亿元**，同比增长 **28.40%**；实现归属于母公司净利润 **13.06 亿元**，同比增长 **23.93%**。根据管理层初步预测，公司预计 2026H1 实现营业收入 **62.0 亿元至 72.0 亿元**，较 2025 年同期增长 **33.22%至 54.71%**；预计实现归母净利润 **9.0 亿元至 10.5 亿元**，较 2025 年同期增长 **51.59%至 76.85%**；预计实现扣非归母净利润 **9.0 亿元至 10.5 亿元**，较 2025 年同期增长 **64.53%至 91.95%**。

公司聚焦印制电路板与电子元器件领域；根据主营业务的相似性，选取兴森科技、金百泽、迅捷兴、四会富仕、强达电路、云汉芯城为嘉立创的同行业可比上市公司。从上述可比公司来看，2025 年可比上市公司的平均收入规模为 **24.51 亿元**，平均 **PE-TTM**（剔除异常值及负值/算术平均）为 **69.35X**，平均销售毛利率为 **20.59%**；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。

表 2：同行业上市公司指标对比

代码	简称	总市值 (亿元)	PE-TTM	2025 年营业收入(亿元)	2025 年 营收增速	2025 年归母 净利润 (亿元)	2025 年归母 净利润 增速	2025 年 销售毛利 率	2025 年 ROE (摊 薄)
002436.SZ	兴森科技	595.06	412.32	71.95	23.68%	1.35	168.06%	19.57%	2.62%
301041.SZ	金百泽	23.07	102.97	7.01	2.62%	0.20	-48.39%	23.46%	2.95%
688655.SH	迅捷兴	42.26	-184.73	6.89	45.21%	-0.22	-1033.7%	14.43%	-3.35%
300852.SZ	四会富仕	62.43	48.43	19.32	36.69%	1.28	-8.67%	20.77%	6.64%
301628.SZ	强达电路	54.89	46.89	9.54	20.24%	1.21	7.31%	29.38%	10.74%
301563.SZ	云汉芯城	102.83	79.09	32.38	25.62%	0.99	12.02%	15.92%	10.07%
	平均值	146.76	69.35	24.51	25.68%	0.80	-150.56%	20.59%	4.95%
001232.SZ	嘉立创	/	/	102.32	28.40%	13.06	23.93%	28.13%	20.11%

资料来源：iFind（数据截至日期：2026 年 7 月 22 日），华金证券研究所

备注：PE-TTM 计算剔除 PE 值偏高的兴森科技，以及 PE 值为负的迅捷兴。

（六）风险提示

大规模扩产后产能爬坡及业绩波动的风险、技术持续升级迭代风险、原材料价格波动风险、存货减值的风险、经营业绩波动和增速放缓的风险、汇率波动的风险、物流成本增加的风险、实控人不当控制风险、税收优惠及政府补助风险、国际贸易摩擦的风险、信息系统及数据安全风险等。

投资评级说明

公司投资评级：

买入 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%；

增持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%至 15%之间；

中性 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%至 5%之间；

减持 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅在 5%至 15%之间；

卖出 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数跌幅大于 15%。

行业投资评级：

领先大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数领先 10%以上；

同步大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨跌幅介于-10%至 10%；

落后大市 — 未来 6-12 个月内相对同期相关证券市场代表性指数落后 10%以上。

基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数为基准。

分析师声明

李蕙、戴箴箴声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址： www.huajinsc.cn